

LED封装晶圆手动贴膜机

产品名称	LED封装晶圆手动贴膜机
公司名称	深圳市锐邦科技有限公司
价格	36000.00/个
规格参数	别名:8寸晶圆手动贴膜机 品牌:UIBONTEC 适用机械:半导体封装
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区南岸新港联工业区第七幢三楼东
联系电话	13823290891

产品详情

设备功能简述：

深圳锐邦科技有限公司研发的贴膜机是专门用于晶圆、qfn和陶瓷切割后的贴膜设备，该机采用铝合金材质外壳，抗静电特氟龙台盘，进口温控系统，使整机性能更加稳定。该机特有的省膜设计能大大降低贴膜成本，且配有带弹力可调的压力滚动和台盘。易用，无需培训就立即上手操作。

主要功能：

适用于蓝膜、uv膜、pet衬底膜和双层膜。

可选配的能应用于超薄晶圆的微孔贴膜台盘。

加热的且带弹力的贴膜台盘设计可自适应不同厚度的晶圆。

特有的贴膜滚轮压力可调设计。

配备圆周刀和横切刀。

可选配的离子风棒静电去除装置。

体积小，桌面摆放型。

fm200 最大适用于8"晶圆

最省膜的手动贴膜机：

特别设计的省膜结构，让fm系列贴膜机成为最省膜的手动贴膜机，比普通手动贴膜机可节约15%左右，大大降低了客户的贴膜成本，在目前或将来使用昂贵的uv膜时，成本节省的效果会更显著。

适用于超薄晶圆的微孔贴膜台盘（选配）：

微孔设计的贴膜台盘加上特有的气路设计和弹力支持结构，可适用于最低100um厚度的晶圆、玻璃或陶瓷；此结构和弹力可调的滚轮装置可最大限度地减少在贴膜时对超薄晶圆的损坏，最大限度地降低破片机率。

带加热功能和弹力的防静电特氟龙表面处理贴膜台盘：

带加热且加热温度范围可调的台盘设计，保证贴膜粘合效果能调至最佳状态。

带弹力的台盘可自适应不同厚度的晶圆、玻璃或陶瓷。

表面防静电的特氟龙处理不但可以把贴膜时产生的静电减到最低而且还能有效防止对芯片的物理划伤。

本机带有自动收膜系统可以适用于带保护膜的双层膜。

技术规格：

项目	参数：fm200	单位
适用晶圆尺寸	3~8	inch
适用最小晶圆厚度	普通台盘：150um；微孔台盘：100um	um
适用frame尺寸	6/8	inch
台盘加热温度范围	室温~65	
组件更换时间	<10	分钟
机器尺寸	900(d)x450(w)x400(h)	mm
电源	ac220	v
压缩空气	0.5~0.8	mpa

注意：可选装配置，不同配置价格不同！详细请来图来电话咨询！

咨询电话：138-2329-0891黄经理

本产品的别名是8寸晶圆手动贴膜机，品牌是UIBONTEC，适用机械是半导体封装，型号是FM200，规格是8寸，产品别名是手动贴膜机，产品用途是半导体封装，适用行业是半导体类机械